

京都実装技術研究会は、昭和62年に発足し、電子機器の生産に深く関わる基盤技術である接合・実装技術を中心に、生産現場の高度化のために必要な課題や各社が抱えている共通の問題をテーマにした研究会活動を行い、技術水準の向上に努めています。本記事では京都実装技術研究会の令和5年度の活動についてご紹介します。

京都実装技術研究会では、各分野のトップランナーをお招きして最新の情報について学ぶセミナーを開催したり、はんだ付けの実習や工場見学会を実施しています。

セミナーは実習が伴うものを除き、Webを使った参加と会場での参加のどちらも可能なハイブリッド形式で実施しています。各例会に合わせて会員同士の交流を目的とした懇親会も開催しています。

令和5年度の活動について下記のとおり実施しましたのでご紹介します。詳細については京都実装技術研究会のHPからご確認ください。令和6年度も引き続き、活動予定ですのでぜひご入会ください。

●第1回例会／オープニングセミナー 令和5年5月30日

世界半導体産業・技術の流れと日本の立ち位置

講師:津田 建二 氏/国際技術ジャーナリスト・News&Chips編集長
セミコンポータル編集長

世界の半導体は今、どのような方向に向いているのか、それに対して日本の立ち位置はどうなっているか。世界のヒントと今後の半導体のあるべき姿について

●第2回例会 令和5年7月20日・21日

リフロー炉 実演講習

講師:河合 一男 氏/実装技研 実装技術アドバイザー
浅野 光一 氏/アントム株式会社
簡易マスク(紙製)を作製してはんだ印刷、リフローを交えた、温度プロファイルの設定や仕上がりの確認について

●第3回例会 令和5年10月12日

①レーザーはんだ付け技術とその最新動向

講師:酒川 友一 氏/株式会社ジャパンユニックス
こて付け及びレーザーはんだ付工法の特徴、市場の評価、並びに日々進歩している最新のはんだ付け技術動向について

②フラックスを使用しない、ギ酸還元リフローの利点

講師:嘉登 浩一 氏/ユニテンプジャパン株式会社 代表取締役
ギ酸還元リフロー技術の利点であるポイドレス、フラックスレスはんだリフローについて

●第4回例会 令和6年2月9日

はんだポイド／クラック進展と深層学習を利用した新規解析方法

講師:植木 竜佑 氏/株式会社クオルテック
高橋 政典 氏/株式会社クオルテック
はんだクラックの発生原因や評価方法、AI・ディープラーニング技術を活用したはんだ不良解析方法について

●工場見学会 令和6年1月19日

HORIBAグループ見学会

株式会社堀場製作所様及び関連事業所の工場を訪問し、実装の現場や設備などを見学させていただきました。

見学先:株式会社堀場製作所 本社・びわこ工場
株式会社堀場エステック
株式会社堀場アドバンスドテクノ
株式会社堀場テクノサービス

●実装技術スキルアップセミナー 令和6年1月30日

はんだ付け実習

講師:河合 一男 氏/実装技研 実装技術アドバイザー

岩田 智寛 氏/双和電機株式会社
岡本 和也 氏/双和電機株式会社

初心者から経験者までを対象に当研究会オリジナルの練習用基板を使用して、手はんだ付けの実習を行いました。



オープニングセミナーの様子(5月30日)



はんだ付け実習の様子(1月30日)

毎年、年度頭初に開催するオープニングセミナーは会員以外の方にも無料でご参加いただけます。

ご興味のある方は事務局(応用技術課 電気通信係)までお気軽にお問い合わせください。